

导热填隙垫片 (RTP)

○ 产品描述

导热填隙垫片是以有机硅或者非硅树脂作为基体，填充导热颗粒复合而成。导热系数可以从 1 W/mK 到 10 W/mK，并且保持良好的弹性。可用于覆盖在不平整或者不规则的器件表面，充分填充发热器件和散热器或者金属外壳之间的间隙，使热量更有效地传到散热器上，从而提升器件的运行效率和使用寿命。

导热填隙垫片具有自粘性，无需背胶。为了一些特殊的使用需要，也提供单面或者双面不粘的产品以便于操作。

○ 产品特点

多种导热系数可以选择

自粘性或者单面粘性

符合 RoHS 规范

颜色或者尺寸可以定制

RTP 系列提供常规硬度产品，减少使用时的接触热阻

RTP C 系列提供更高的性价比方案

RTP S 系列提供超低硬度的导热垫片，满足压缩在超过 50% 条件下的使用，同时不产生过大的应力。

所有系列的产品都可以提供玻纤增强（后缀 F）以及单面粘性处理（后缀 DC1）

○ 典型应用

机箱或者相关散热模块

LED 照明

内存模块

主机和小型办公室网络设备

大型存储设备

电源

汽车电子设备

通信设备

无线电设备



○ 技术参数

@ 厚度公差: <1mm, +/-0.1mm @ 标称厚度 . >1mm, 10% 标称厚度 @ 击穿电压: 500V/s 升压速率, 20mA 漏
电电流

典型性能		RTP10	RTP15	RTP20	RTP30	RTP30S	RTP30C	RTP40	RTP50	RTP70	RTP80	RTP90	测试方法	
物理性能	密度 (g/cc)	2.2	2.5	2.6	3.1	3.0	2.7	3.1	3.1	3.2	3.1	3.3	ASTM D792	
	厚度 (mm)	0.25-5.0				0.5-5.0	0.25-5.0			0.5-5.0			1-5	ASTM D374
	硬度 (shore 00)	40				10	40						ASTM D2240	
热性能	导热系数 (W/m.k)	1.0	1.5	2.0	3.0	3.0	3.0	4.0	5.0	7.0	7.5	9	Hot Disk	
		1.2	1.7	2.3	3.4	3.4	3.4	4.6	5.6	7.5	8.0	10	ASTM D5470	
	操作温度 (°C)	-55-200											/	
电性能	击穿电压 (v/mm)	8000					1000	8000			1500	300	ASTM D149	
	体积电阻率 (Ohm-cm)	>10 ¹³											ASTM D257	
	介电常数 @1MHz	5.8	5.8	6.0	6.0	3.8	16.3	4.2	7.9	9.8	12.8	16.5	ASTM D150	
常规性能	阻燃等级	V-0											UL94	
	RoHS	符合											/	
	保质期 (月)	12											/	